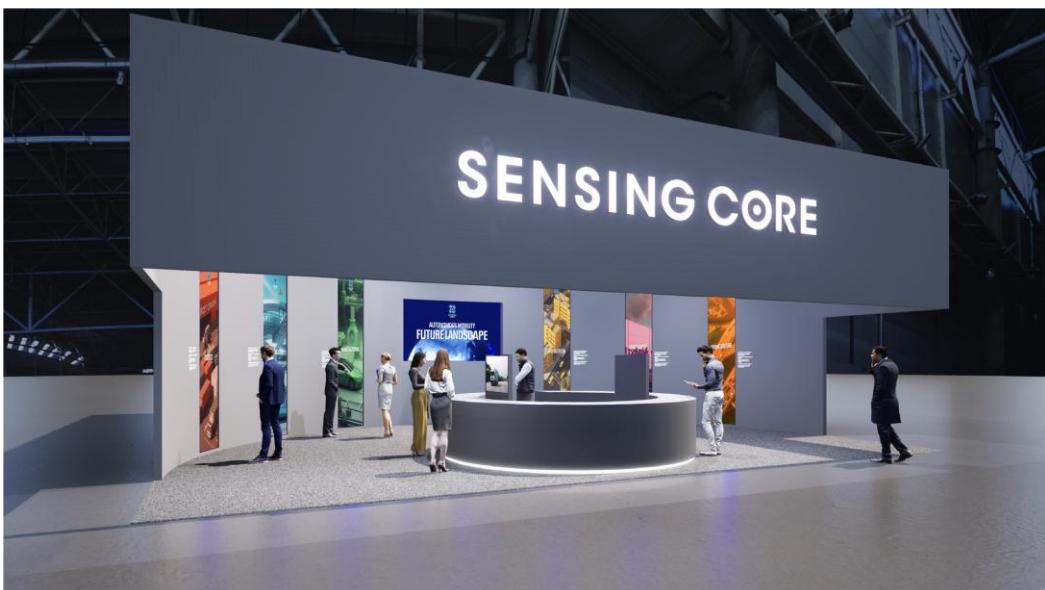


発行: 2025 年 12 月 15 日

世界最大級の技術展示会「CES2026」にブース出展

～未来の自動運転の安全を支えるセンシングコア技術を紹介～

DUNLOP(社名:住友ゴム工業(株)、社長:山本悟)は、2026年1月6日から9日に米国・ラスベガスで開催される世界最大級の技術見本市「CES2026」^{*1}(主催:全米民生技術協会)に独自のセンシング技術「センシングコア」ブースを出展します。



ブースイメージ

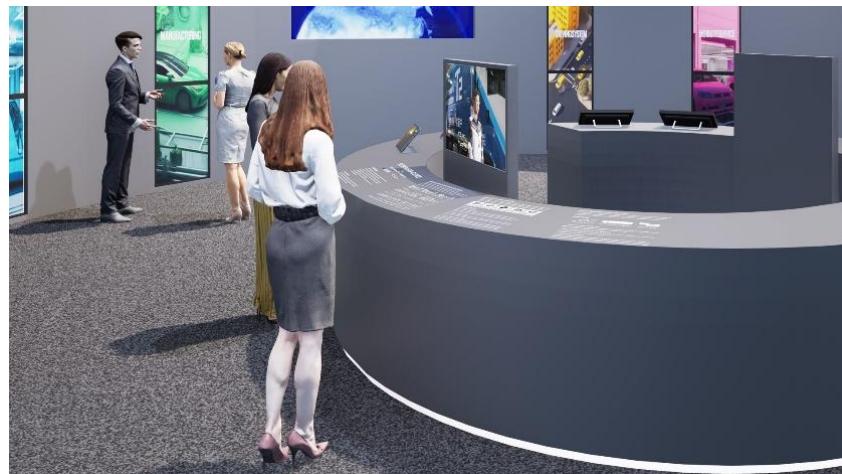
ブースでは、モビリティ社会の安全を支えるセンシングコアについて、世界で実用化と実装が進む「未来の自動運転社会への貢献」そして「技術プラットフォームとしての現在の取り組み」を紹介します。

■「未来の自動運転社会への貢献」展示

ブース内に立ち上がるディスプレイでは「物流」「公共交通」「自動車製造」「走行支援」「モビリティサービス」「交通インフラ」という6つの未来の展望を体験いただけるコンテンツを展示します。

■「技術プラットフォームとしての現在の取り組み」展示

中央のテーブルでは、2025年8月に買収した米・AIソリューション会社 Viaduct, Inc.(以下、「Viaduct(バイアクト)社」)が持つAI技術とセンシングコア技術を組み合わせたフリートサービスや、自動運転トラックによる幹線輸送の商用運行サービスを手掛ける株式会社 T2(ティーツー)^{*2}との技術検証の模様をご紹介いたします。



2026年からはViaduct社のソリューションも加わり、フリート車両向け故障予知サービスをより効率的に推進するとともに、日本や欧州などグローバルでのサービス展開を加速させていきます。

センシングコアは、自動運転の普及が進む社会において安全性の向上に寄与し、モビリティの進化と発展に大きく貢献できる技術であると考えています。センシングコアが収集するタイヤ周辺や路面状態のデータは、モビリティの制御に活用されるだけでなく、クラウドを通じて社会の情報と統合されます。これにより、より安全で快適なモビリティライフの実現を目指し技術開発を進めてまいります。

※1 「CES2026」公式サイト(英語):<https://www.ces.tech/>

※2 T2 の公式サイト:<https://t2.auto/>

【ブース出展概要】

- 出展期間 : 2026年1月6日(火)～1月9日(金)
- 会場 : Tech East 内 Las Vegas Convention Center West Hall
(3150 Paradise Rd, Las Vegas, NV 89109, USA)
- ブース番号 : 7041
- 展示内容 : センシングコア
- プレスブリーフィング : 2026年1月6日(火) 11:30～12:00

[登壇者]

住友ゴム工業株式会社 代表取締役社長 山本悟

Viaduct, Inc. Founder & CEO David Hallac

[場 所]当社ブース内

[内 容] センシングコアや Viaduct 社が保有する AI 技術を活かしたオートモーティブシステムソリューションの紹介、今後の展望など